

中国国际金融股份有限公司

关于合肥晶合集成电路股份有限公司

2025 年半年度持续督导跟踪报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，针对晶合集成 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日（以下简称“报告期”）经营情况，出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与晶合集成签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2025 年上半年度晶合集成在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等	2025 年上半年度晶合集成在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等情况。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式了解晶合集成业务情况，对晶合集成开展了持续督导工作。

序号	工作内容	持续督导情况
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	2025 年上半年度，保荐机构督导晶合集成及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事、高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促晶合集成依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对晶合集成的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，晶合集成的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促晶合集成依照相关规定健全和完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对晶合集成的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对晶合集成的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2025 年上半年度持续督导期间内，晶合集成及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应及时向上海证券交易所报告	2025 年上半年度持续督导期间内，晶合集成及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
14	关注社交媒体关于上市公司的报道和传闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2025 年上半年度持续督导期间内，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。

序号	工作内容	持续督导情况
15	发现以下情形之一的，保荐机构应当督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《股票上市规则》等本所业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形	2025 年上半年度持续督导期间内，晶合集成未发生左述情况。
16	保荐机构应当制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。
17	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	本持续督导期间，晶合集成不存在需要专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、研发人员不足或流失风险

集成电路晶圆代工行业兼具资本密集、技术密集、管理密集及人才密集等综合特征，因此稳定且专业的研发团队是公司持续发展的基石。随着集成电路行业的蓬勃发展，企业数量不断增长，竞争随之加剧，尤其人才的争夺战愈演愈烈。对此，公司加强对人才梯队建设的重视，通过实施股权激励、完善职业发展通道等多元化举措，持续吸引并保留高端技术人才，现已构建起一支经验丰富、稳定可靠、创新能力卓越的核心研发团队，在新产品与先进制程的研发及量产方面发挥了关键作用。尽管正常范围内的人才流动不会对研发与经营造成重大不利影响，但若核心技术人

员出现集中流失，仍可能对研发进度、工艺稳定性及新产品落地产生显著冲击，进而削弱公司市场竞争力。

2、产品开发风险

集成电路晶圆代工业务涉及数十种科学技术及工程领域的学科知识，技术复杂程度高，终端应用广泛，导致不同细分领域的芯片产品在主流技术节点和工艺上存在显著差异。市场的快速变化还要求公司必须持续跟踪并研究客户需求，不断更新设计规格、产品性能等以跟上主流行业趋势。但从新技术的研发到最终实现产业化，具有资金投入大、研发周期长、结果不确定性高等特点，如果公司无法在相关技术及工艺领域紧跟技术迭代，亦或大量研发投入未能获得理想效果及适应需求变化，可能导致新产品无法顺利通过客户的产品导入和认证，或者良率偏低、交付时间延长，致使公司发展后劲不足，在市场竞争中处于不利地位。

3、核心技术外泄或失密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司储备了一系列具有自主知识产权的核心技术，拥有覆盖研发及生产全流程的上千项专利，同时，公司仍在持续进行多项针对主营业务的技术研发工作。公司十分重视对核心技术的保护工作，通过申请专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计等方式对核心技术赋予法律层面的严密保护；并制定了保密制度，对核心技术人员在保密义务、知识产权及离职后的竞业情况作出了严格规定；同时，通过对访问权限管控、敏感信息监测等方式强化网络安全屏障，以保护公司的合法权益，防止核心技术外泄。但由于技术秘密防护手段的局限性及其他不可控因素，在人员流动、上下游业务交流的过程中，公司的技术和研发成果仍可能遭遇泄露风险，从而对公司核心竞争力造成负面影响。

（二）经营风险

1、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户的主营销售收入合计 297,923.10 万元，占主营业务收入的比例为 58.08%，客户集中度较高。公司凭借自身的研发能力、产品品质、产能支持、客户服务等综合优势，与核心客户维持了良好的协作关系，并已与部分客户签署了长期合作的框架协议，合作范围和合作深度较好，为业务的稳定性奠定了

基石。未来，若主要客户因自身产品布局优化、技术路径转变、增加或更换供应商、下游需求变化等因素调整采购策略，或者公司自身在产品研发、生产经营等方面未能持续满足客户需求，导致订单量大幅下降，将对公司生产经营和盈利能力产生不利影响。

2、新产品需求不及预期风险

公司始终重视新产品、新制程和特色工艺平台的研发，目前 55nm 中高阶单芯片及堆栈式 CIS 芯片已批量生产，40nm 高压 OLED 显示驱动芯片已实现批量生产，28nm 逻辑芯片通过功能性验证。新产品的陆续研发完成并通过认证及量产，将会给公司经营业绩带来新的增长点。但市场趋势或行业标准的变化、客户需求的波动、优势竞品的冲击都可能导致公司的新产品无法快速导入市场及放量，公司存在新产品需求不及预期的风险。

3、公司产品结构相对集中的风险

公司主要从事 12 英寸晶圆代工业务，目前的主要产品包括 DDIC、CIS、PMIC、MCU 和 Logic。报告期内 DDIC 产品的营收占比约为 60.61%，但自 2023 年起，CIS 产品的营收占比逐年上升，产品结构不断改善。公司也在不断进行 PMIC、MCU 和 Logic 等其他技术平台的研发和持续优化工作，并积极开拓市场，但新产品的开发及产业化需要投入大量的资金和时间，且面临市场接受度、客户认证及竞争态势不确定性的风险。因此，在短期内，如果 DDIC 市场需求发生较大波动，导致公司在该领域的生产或销售出现不利变化，则可能对公司的盈利能力、经营性现金流产生不利影响。

4、公司无法及时消化新增产能的风险

为更好地满足市场需求，公司将根据市场动态、客户需求及自身发展战略进行弹性产能扩充。针对产能扩充，公司已进行了深入的市场调研和可行性分析，并在技术工艺、市场开拓、人员储备等方面做好了充分准备，但外部环境的不确定性仍可能带来挑战。若宏观经济环境、国家产业政策或技术发展方向发生重大变化，导致下游市场增速不及预期、核心客户需求改变，或同业竞争者加速扩产导致市场供需失衡，公司将面临产能释放节奏和市场需求节奏不匹配致使无法及时消化新增产

能的风险，则可能对公司的经营业绩造成不利影响。

（三）财务风险

1、固定资产投资的风险

为把握市场机遇、提升客户服务能力并强化市场地位，公司采取产能扩张战略，需新建设施、采购及安装先进制造设备，固定资产投资规模较大。尽管已制定审慎的资本开支计划并为之配套了多元化的融资方案，但在产能实际建置过程中，受制于宏观经济波动、货币政策调整及资本市场融资环境变化等不可控因素，公司仍可能面临资金压力。与此同时，随着大额固定资产的增加，折旧费用也将相应上升，但经济效益的提升需要一定的时间，若公司未来产销规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，可能会对公司的盈利水平产生阶段性压力。

2、存货跌价风险

报告期末，公司的存货账面价值为 164,554.75 万元，占总资产比例为 3.21%；存货跌价准备金额为 7,701.53 万元，对应存货期末余额的计提比例为 4.47%。公司的生产策略以销售订单为核心，并考虑客户的中期需求来制定生产计划，进行适度备货，以保证销售与生产的匹配与衔接。若未来市场环境发生不利变化、客户需求出现非预期调整、市场竞争加剧或技术迭代加速，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，将导致产品滞销、存货积压，公司将面临存货跌价的风险。

3、毛利率波动风险

报告期内，公司综合毛利率为 25.76%。公司产品规格数量较多，不同制程和品类的产品在单价与毛利率上存在差异，产品结构的调整将直接影响毛利率水平。同时，公司的成本结构以固定性成本为主，主要包含厂房、设备及产线的折旧，因此价格和稼动率的波动对毛利率影响较大。未来，如果市场供求关系、公司议价能力、技术发展趋势等发生重大不利变化，导致营业收入规模出现显著波动，或流失高毛利率业务，或新增产能未能达到预期稼动率，公司将面临毛利率波动的风险。

4、外币汇率波动风险

报告期内，公司存在境外销售和采购的情况，相关款项主要采用美元或日元进

行结算，因此持有相应的外币货币性资产。虽然公司在业务开展时已考虑了订单签订及款项收付期间汇率波动的可能性，也持续平衡外币货币性资产规模以降低汇兑损益对财务表现的影响，但如果未来境内外经济环境、政治局势或金融政策等因素发生显著变化，使得外币汇率出现剧烈波动，将直接影响公司境外原材料采购成本及产品销售收入的折算金额，进而可能对经营业绩造成不利影响。

（四）行业风险

1、产业政策变化风险

集成电路产业是我国的战略性支柱产业，近年来国家陆续出台文件进行积极引导，自上而下地为行业构建了系统性的支持体系。各级地方政府亦同步配套税收优惠、融资支持、财政补贴、人才引进及知识产权保护等一揽子举措，为产业链各环节企业营造了良好的发展环境。在政策驱动下，国内集成电路行业在芯片设计研发、先进制程工艺突破及关键核心技术自主可控等方面取得显著进步。若未来产业政策方向发生调整（如财税优惠退坡、补贴力度减弱或行业准入规则变化等），可能对公司技术研发、高端人才储备、产能扩张节奏及市场竞争力产生潜在不利影响。

2、行业竞争加剧的风险

近年来，集成电路行业在国家政策引导及地方产业配套支持下已形成高速增长态势，良好的行业前景吸引了更多的市场新进入者以及资本力量的汇聚，共同推动了行业的繁荣。然而，伴随产能规模化释放，市场供给不断增加，行业竞争进一步激烈。尽管公司通过自主研发，在工艺迭代、新产品开发方面取得了不错的进展，并构建了较为完整的技术储备与量产经验体系，但在核心技术壁垒构建、高端市场渗透能力等方面仍与行业龙头企业存在一定差距。未来，倘若公司未能有效提升工艺技术规划的前瞻性、加快产品矩阵创新升级的步伐，或是未能及时响应客户的定制化需求，则可能导致公司产品的竞争力下降，从而对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

3、供应链风险

集成电路行业对核心原材料、精密零部件、专用软件及高端设备的品质与适配性具有严苛标准，是保证公司稳定生产的必要条件，但部分重要原材料、零部件、

专用软件、核心设备等的全球合格供应商数量较少，且主要分布于境外市场。尽管公司持续强化供应链安全体系建设，积极推动关键设备及材料的国产化替代，以降低对外部供应的依赖，但国际贸易环境不确定性的影响依然存在。若因地缘政治等其他不可抗力的因素，导致公司的重要材料、零备件、软件、设备等的出口许可、物流受到限制或成本上涨，将对公司产能规划实施效率、技术迭代进度、客户关系维系带来潜在不利影响，从而影响公司的整体运营和发展。

（五）宏观环境风险

1、国际贸易摩擦加剧的风险

在全球经济一体化的大环境下，国家之间的经济往来与政治互动紧密相关，国际形势的变动直接影响着国际贸易的格局，也对特定产业的发展产生深远的影响。近年来，国际贸易摩擦不断，集成电路产业成为贸易冲突的重点领域，部分国家采用提高关税、出口管制、技术限制等非市场化干预措施，客观上制约我国产业链生态的协同发展进程。尽管公司在经营过程中始终遵守中国及他国法律法规，但国际环境的复杂性和多变性意味着，国际贸易政策可能突然发生不利变更，将对公司的业务拓展和供应链管理带来限制，进而影响公司的正常运营。

2、宏观经济波动和行业周期性风险

公司主要从事集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售，属于集成电路行业的中游环节。由于行业固有的周期性特征，公司的业务表现与宏观经济周期及下游行业的发展状况紧密相连。若未来宏观经济形势发生重大变化，终端需求低迷，将导致 IC 设计公司新产品发布延迟、下游厂商备货策略趋于谨慎或施加更大的定价压力，包括公司在内的集成电路企业将面临一定的行业波动风险，对经营情况造成不利影响。

四、重大违规事项

2025 年上半年度持续督导期间，晶合集成不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年 1-6 月，晶合集成主要会计数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2025年1-6月	2024年1-6月	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	5,198,454,703.34	4,397,777,256.70	18.21
利润总额	232,046,990.31	194,858,870.41	19.08
归属于上市公司股东的净利润	332,128,758.87	187,002,537.88	77.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,831,533.70	94,674,882.94	115.30
经营活动产生的现金流量净额	1,705,034,907.06	1,295,165,395.36	31.65
主要会计数据	2025年6月末	2024年末	本报告期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	21,024,780,291.61	20,870,311,007.81	0.74
总资产	51,206,485,180.79	50,398,579,443.20	1.60

2025 年 1-6 月，晶合集成主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2025年1-6月	2024年1-6月	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	0.17	0.10	70.00
稀释每股收益（元 / 股）	0.17	0.10	70.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.10	0.05	100.00
加权平均净资产收益率（%）	1.58	0.86	增加0.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.97	0.44	增加0.53个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	13.37	13.97	减少0.60个百分点

报告期内，晶合集成上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

营业收入较上年同期增加 80,067.74 万元，同比增长 18.21%，主要系报告期内公司销量增加，收入规模持续增长所致。

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加 14,512.62 万元、10,915.67 万元，主要系报告期内公司营

业收入同比增长，以及整体产能利用率维持高位水平，单位销货成本下降，产品毛利水平提升所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40,986.95 万元，主要系本报告期营业收入同比增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.17 元/股、0.17 元/股、0.10 元/股，较上年同期分别增加 0.07 元/股、0.07 元/股、0.05 元/股，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）研发团队经验丰富，技术实力行业领先

公司研发团队核心成员均由境内外资深专家组成，在不同的技术方向具有丰富的研发经验，对行业发展现状和趋势有着深刻的认识和理解。公司已建立完善、成熟的研发机制，高度重视并持续加强研发团队建设及研发能力提升。公司坚持以行业发展趋势和客户需求为导向，积极探索新的业务领域，及时进行产品迭代，满足终端客户的需求。通过多年持续的研发投入，公司积累了深厚的技术储备和丰富的研发经验，截至 2025 年 6 月末，公司共取得专利 1,177 个，其中发明专利 911 个、实用新型专利 266 个。

报告期内，公司研发投入金额达 69,482.02 万元，较上年增长 13.13%。截至 2025 年 6 月末，公司拥有员工 5,492 名，其中研发人员 1,924 名，占员工总数比例为 35.03%，研发人员中硕士及以上占比约 64.76%。

（二）产品结构不断丰富，工艺平台多元发展

公司已实现 DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic 等工艺平台量产，产品结构日益多样化，产品应用涵盖智能手机、电脑、平板显示、汽车电子、智能家用电器、工业控制、物联网等诸多领域。报告期内，公司不断推出有市场竞争力的新产品，进一步优化了产品结构。40nm 高压 OLED 显示驱动芯片、55nm 全流程堆栈式 CIS 芯片实现批量生产。

（三）位居合肥战略核心，产业链协同效应强

公司地处国家级科技创新型试点城市合肥市。合肥市基于“芯屏汽合”的产业发展战略，已形成新型显示器件、集成电路、新能源汽车和人工智能等新兴产业。集成电路产业也是合肥市重点发展的战略性新兴产业，目前已集聚几百家产业链上下游重点企业，构建了从设计、制造、封装测试、装备材料，到公共服务平台的完整产业链生态。公司所处的代工环节为半导体产业链中最为重要的环节之一。公司充分发挥本地终端市场距离近、规模大的优势，依靠成熟制程制造经验，服务于合肥产业链规划，提供关键芯片，促进产业链协同联动发展，打造稳定、共赢的生态圈。

（四）客户关系紧密稳固，推动国产供应替代

公司对客户的核心需求、产品变动趋势、最新技术要求理解深刻，依靠稳定的交付能力、卓越的品质和优秀的服务获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认可，与众多客户建立了长期、紧密、稳固的合作。公司客户群体覆盖部分国际一线公司。公司通过与战略客户的紧密协作，研发生产更贴近客户需要、符合市场需求的产品。同时公司在业界具有良好的口碑及供应商基础，最大程度地采用国产化设备与材料，保证供应链安全，推动国产供应替代。

（五）体系认证齐全，质量稳定可靠

公司建立了完善的质量管理体系，依托产品研发及工艺技术的综合实力保证并提升产品品质。截至目前，公司已取得质量管理体系认证 ISO9001、环境管理体系认证 ISO14001、职业健康安全管理体系认证 ISO45001、有害物质过程管理体系 QC080000、温室气体排放盘查认证 ISO14064 等诸多认证。此外，在车用芯片领域，公司已取得车载质量管理体系 IATF16949 认证。

（六）智能制造，高效稳定，成本具有竞争力

公司智能生产线拥有高端智能制造营运管理制度及系统，涵盖数字化生产系统、自动化无人搬运系统、车间自动化控制系统、智能品质与设备监控系统、智能生产派工系统等，可为客户提供更优质代工服务及更稳定的产品品质。公司成功将人工智能技术全面导入研发、营运等环节，实现 AI 智造升级及全局优化。同时公司积极

推动关键原辅材料和设备的国产化。公司生产集中在同一园区内，本地产业链配套较为齐全，从原材料到整机产业链，可实现就近供应，且最大程度地采用国产化设备与材料，产品成本更具竞争力。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

单位：元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	变化幅度（%）
费用化研发投入	694,820,162.03	614,182,514.17	13.13
资本化研发投入	/	/	/
研发投入合计	694,820,162.03	614,182,514.17	13.13
研发投入总额占营业收入比例（%）	13.37	13.97	减少 0.60 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	/	/	/

（二）研发进展

公司始终高度重视自主知识产权技术和产品的研发，聚焦核心技术，紧跟行业前沿技术以及传统领域与新兴市场的发展趋势，以客户和市场需求为导向，不断规划和研发更丰富的工艺平台，持续进行研发投入，推进技术迭代升级，以增强公司在产业中的核心竞争力，稳固公司的行业地位。

报告期内，公司研发费用投入 69,482.02 万元，较上年同期增长 13.13%，占公司营业收入的 13.37%，报告期末公司共有员工 5,492 人，其中研发人员 1,924 人，占比 35.03%。报告期内公司新获得发明专利 139 项、实用新型专利 42 项。截至报告期末公司累计获得专利 1,177 个。

报告期内，公司研发进展顺利，取得了显著的成果，新产品逐步导入市场,如 40nm 高压 OLED 显示驱动芯片实现批量生产、28nm 逻辑芯片持续流片、55nm 堆栈式 CIS 实现全流程生产以及 55nm 逻辑芯片和 110nm Micro OLED 芯片实现小批量生产。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099 号）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	9,723,516,459.91
加：未置换的以自有资金支付的发行费用（印花税）	2,431,486.99
加：利息收入扣除银行手续费净额	116,652,830.14
减：募集资金投资项目支出(a+b+c)	8,231,579,564.05
其中：直接投入募集资金项目的金额(a)	5,063,492,999.60
以募集资金置换预先投入项目的自筹资金的金额(b)	2,075,224,554.41
使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额(c)	1,092,862,010.04
减：节余资金永久补充流动资金	344,437,420.65
减：超募资金永久补充流动资金	60,000,000.00
减：超募资金回购公司股份	164,520,697.56
减：报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金	500,000,000.00
截至2025年6月30日募集资金专户应有余额(d)	542,063,094.78

项目	金额
截至2025年6月30日募集资金专户实际余额(e)	542,063,094.78
差异(d-e)	0

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	备注
合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	20000515418466600000057	167,610,905.12	
合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	20000515418466600000164	362,275,595.80	
中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	181267662902	3,275,292.58	
中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行	12181001040035296	6,466,871.14	
招商银行股份有限公司合肥分行	551904996610555	0.00	2024年7月17日销户
兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行	499050100100419345	0.00	2024年7月19日销户
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129200389609	0.00	2024年5月17日销户
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002618	2,434,430.14	
合计		542,063,094.78	/

1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过人民币 20 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过人民币 15 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 670,776,197.70 元，其中 170,776,197.70 元为协定存款，500,000,000.00 元为券商收益凭证。

2、节余募集资金使用情况

募投项目“40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”结项：公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”予以结项，并将节余募集资金 35,323.63 万元（未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充公司流动资金。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未将节余募集资金从募集资金存放专项账户转出。

3、募集资金使用的其他情况

使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换：2023 年 6 月 21 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用基本存

款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金等额置换。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-006）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式累计支付了募投项目所需资金共计 1,197,066,617.76 元，以募集资金 1,092,862,010.04 元进行了等额置换，剩余 104,204,607.72 元待置换。

4、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，董事会同意本次终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）”，并将该项目拟投入募集资金 35,595.58 万元（含现金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）变更投向至其他募投项目“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”，并授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过本次事项后办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项已于 2025 年 5 月 28 日经公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-002）、《晶合集成 2024 年年度股东会决议公告（公告编号：2025-030）》。

（二）募集资金合规情况

公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2025 年 1-6 月，晶合集成现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员持有公司股份不存在变动的情况。

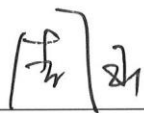
截至 2025 年 6 月 30 日，晶合集成控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

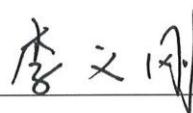
截至本持续督导跟踪报告出具之日，公司不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



周 玉



李义刚

